



证券代码：002213

证券简称：大为股份

公告编号：2021-033

深圳市大为创新科技股份有限公司 关于子公司投资设立香港子公司的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市大为创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年2月5日披露了《关于子公司投资设立香港子公司的公告》，公司控股子公司深圳市芯汇群微电子有限公司（以下简称“芯汇群”）拟在香港投资设立芯汇群科技香港有限公司（暂定名，最终以相关主管机关的核准结果为准；以下简称“香港芯汇群”），香港芯汇群注册资本为100万美元，芯汇群以自有资金出资100万美元，占香港芯汇群总股本的100%。详情参见公司于2021年2月5日披露在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于子公司投资设立香港子公司的公告》（公告编号：2021-007）。

近日，公司控股子公司芯汇群收到香港特别行政区公司注册处为香港芯汇群签发的《公司注册证明书》、《商业登记证》，相关信息如下：

1、公司名称：芯汇群科技香港有限公司

英文名称：SXMICRO TECHNOLOGY HK LIMITED

2、注册地址：ROOM 1450, 14/F, ETON TOWER, 8 HYSAN AVENUE, CAUSEWAY BAY, HONG KONG

3、注册资本：100 万美元

4、公司注册证明书编号：3027707

5、商业登记证号码：72779659-000-03-21-6

6、公司注册证明书签发日期：2021年3月15日

截至本公告日，芯汇群尚在办理有关主管部门的审批，敬请投资者注意投资风险。公司将根据信息披露的相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

深圳市大为创新科技股份有限公司

董 事 会

2021 年 4 月 12 日